

Comunicato stampa - 20/10/2026

Ucima porta il packaging italiano a Pack Expo 2026

31 aziende nella collettiva italiana a Chicago. Con ICE-Agenzia anche l'evento "Italy meets USA" dedicato al confronto con l'industria statunitense.

È in corso a Chicago **Pack Expo International**, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'industria del packaging, che fino al **21 ottobre** vede una significativa presenza dell'industria italiana delle macchine per il confezionamento e l'imballaggio.

In collaborazione con **ICE-Agenzia**, **Ucima** ha organizzato la partecipazione collettiva di **31 aziende italiane**: Alimec, Altech, Axtra, Easysnap Technology, Elettromeccanica Bonato, Erre Enne, Galdi, Ghezzi e Annoni, Gruppo Tecnoferrari, Imeta, Innova, IPI, L.M., Minipan, Novatec, Opto Engineering, PND, Panini, Pigo, Ricciarelli, Sarp, Senzani Brevetti, Sir, Tech-Pa, Technowrapp, Trivi, TT Italy, Turello, Unitec, Zambelli e Zancaner.

Una presenza particolarmente rilevante considerando il ruolo strategico degli **Stati Uniti per l'industria italiana delle macchine per il packaging**. Nel 2025 l'Italia si è confermata **secondo partner commerciale degli USA nel settore**, dietro la Germania e davanti al Canada, con esportazioni per **953 milioni di euro**, pari al **18,4%** delle importazioni statunitensi. Gli Stati Uniti rappresentano inoltre **la prima destinazione dell'export italiano di settore**, assorbendo circa il **14,4% delle esportazioni complessive**.

Nei primi sei mesi del 2026, l'Italia ha esportato negli Stati Uniti macchine per il packaging per **420 milioni di euro**. Nonostante un lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2025, il nostro Paese mantiene la **seconda posizione tra i principali esportatori verso il mercato statunitense**.

Ad aprire la presenza italiana a Chicago è stato anche **"Italy meets USA – Market insights, Industry Dialogue & Networking Dinner"**, l'evento organizzato il **18 ottobre da ICE-Agenzia e Ucima** presso il **Chicago Athletic Association Hotel**, che ha riunito rappresentanti dell'industria del packaging attivi sul mercato statunitense per un momento di approfondimento e networking.

L'incontro si è aperto con l'intervento di **Rebecca Marquez di PMMI** dedicato al mercato statunitense e ai principali megatrend che ne stanno influenzando l'evoluzione. A seguire, la **tavola rotonda** ha visto la partecipazione di **Luca Aiolfi di Coesia**, **Alfonso Posada di Econocorp** e **Ron Puvak della US Contract Packaging Association**, offrendo un momento di confronto diretto sulle dinamiche e sulle prospettive del settore negli Stati Uniti. La serata si è conclusa con una **networking dinner**, occasione di incontro tra operatori italiani e americani.

La presenza a Pack Expo International e l'iniziativa "Italy meets USA" si inseriscono nelle attività di **Ucima a sostegno dell'internazionalizzazione dell'industria italiana delle macchine per il packaging**, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento delle imprese nazionali e favorire occasioni di confronto nei mercati strategici per il settore.